

证券代码：688125

证券简称：安达智能

## 广东安达智能装备股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 机构策略会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
时间	2024年6月3日 16:00-17:00
参与单位名称	天风证券 温玉章
地点	公司三楼董事会会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：杨明辉先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司主要通过现场参观的形式开展了投资者关系活动，主要交流内容如下：</p> <p>一、公司基本情况介绍</p> <p>广东安达智能装备股份有限公司成立于2008年，于2022年4月15日登陆上海证券交易所科创板上市。公司属于高端专用装备制造业，主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA智能平台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售。产品可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品的智能生产制造，致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。公司产品主要包括点胶机、涂覆机、灌胶机、等离子清洗机、</p>

固化炉、ADA 智能平台、五轴联动数控机床、超快激光设备等多种智能制造装备和点胶阀体、驱控、电机等多种核心零部件，是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备，目前已形成了以高端流体控制设备为核心、覆盖多道工序的多元化产品布局。

公司 2023 年逆势投入目前已取得初步成效，公司产品品类不断丰富，并开拓了特斯拉、比亚迪、捷普、印度 TATA 等众多国内外大客户。2024 年第一季度，得益于公司国际大客户出货的回暖以及汽车电子、新能源等行业应用的拓展，公司实现营业收入 15,192.31 万元，较去年同期增长了 8.19%。

## 二、互动交流

### 1、请问公司新产品和新市场拓展的情况如何？

回复：公司 2022 年上市之后，引进了一批优秀的研发人才和销售人才来积极拓展新产品与新市场，经过了过去一两年的努力，已经取得了初步的成效。在新产品开发方面，2023 年下半年以来，公司除了对精密阀体系列进行更新迭代，还对传统灌胶机、等离子清洗机、喷墨打印机设备进行研发升级，推出了毫克级别精度灌胶机系列产品、智能单彩色喷墨打印机系列产品、视觉引导喷墨打印机和常压尖嘴等离子体、高速旋转等离子体。此外，公司已成功研发出了高端精密机床、超快飞秒激光等产品，丰富了公司产品品类，其中 AMU 系列立式五轴高速加工中心，具备高效率、智能化、物联网、紧凑型、高精度和高加速度六大卓越竞争力。目前这些新产品也陆续推向市场，我们预计也会陆续给公司带来一定的经营增量功效。

在市场开拓方面，公司在巩固消费电子市场之外，加大对新市场的拓展力度，瞄准汽车电子、新能源（特别是氢能源）、半导体的行业市场，已经切入了众多行业大客户，公司去年已经在汽车电子、半导体等行业取得了较好的突破，今年预计继

续在氢能源市场取得较好的突破，上述新市场的拓展也将为公司打造新的增长极。

## **2、请介绍一下公司目前研发投入的情况？**

回复：公司十分注重研发投入，通过对核心部件、关键软件等底层技术的研究投入，掌握智能装备的关键技术，从而打造公司技术竞争力。2023年，公司研发投入10,025.42万元，占公司营业收入的比例为21.22%；2024年第一季度，研发投入2,821.13万元，较去年同期增长了25.05%。

人才引进方面，公司主动引入了多位在光电学、流体力学、电磁、电机、激光、运动控制、AI算法、工业互联系统等方面的专家教授、博士，组建了流体与结构、视觉、机器人、电力电子、驱动与控制、电机六大研究所，不断夯实公司基础底层技术及产品研发能力；同时引进了一批高端软件人才来配合国际大客户的新产品开发，加快大客户新业务的落地。

产品研发方面，公司加大了对智能装备核心部件、智能装备软件系统平台、AOI检测设备的研发投入，提升公司智能装备的技术竞争力并开拓新的智能装备产品。

## **3、公司 ADA 智能平台产品进展？**

回复：公司持续升级 ADA-H 智能平台，2023年进行了 Z 轴电机自主化开发、工艺模组热插拔及软硬件的二级解耦和三级解耦，已实现支持 Windows 与 Linux 双系统操作、通用平台与工艺应用全面适配，使其能完成对多种工艺模组即插即用，支持更精细的工艺需求，真正实现由专用功能设备转变为通用数字化平台设备。2023年以来公司基于 ADA-H 智能平台开发的智能柔性组装设备已实现大客户的工艺验证及部分出货，先后应用到 TWS 耳机点胶工艺、工业电源的组装测试线体、医疗试剂植球等场景，且已在实际应用中实现了不同工站工艺的

	<p>灵活换线。2024 年公司将继续优化 ADA-H 系列智能平台的工艺兼容性，完成新一版的迭代升级。</p> <p><b>4、公司延展大客户新工艺段应用进展情况如何？</b></p> <p>回复：公司除了继续加深已形成竞争优势的 SMT 电子装联工序环节外，2023 年还积极参与到大客户部分终端产品的 FATP 后段组装工艺项目中，陆续进入批量交付。另外，公司根据主要客户产品系列及其 EMS 厂商分布来进行组织架构的调整，设立美国办事处、苏州应用研发部、越南子公司、墨西哥子公司等来对接客户不同地域及不同工艺的项目，以更快、更全地解决方案满足客户各种需求，为客户提供配套服务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 3 日